

2026年全球PCB行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名

报告简介

印制电路板简称PCB，被誉为电子产品之母，是承载电子元器件、实现电气信号互联与机械支撑的核心基础电子构件，依托光刻、电镀、精密钻孔等工艺制成，包含刚性板、柔性FPC、刚挠结合板、高阶HDI、高频高速板、IC封装基板等多元产品形态，构建完整成熟的全球产业链体系。上游供应覆铜板、电解铜箔、特种树脂、干膜、高端制程设备等关键原辅物料；中游承接线路设计、精密制造、电性可靠性检测、批量交付；下游全面覆盖AI算力服务器、通信基站、新能源汽车、消费电子、半导体封装、航空航天、工控医疗等全品类电子终端，是支撑数字算力、汽车电动化、半导体产业运转不可替代的基石制造产业。

当前全球PCB产业呈现产能集中东亚、高端技术分域竞争、市场结构两极分化的格局。国内依托完备的材料、设备、加工配套集群，占据全球核心产能份额，在中端多层板、柔性板领域具备规模化交付优势，同步加速向算力高频板、IC载板等高壁垒赛道突破；日韩及欧美头部厂商凭借长期材料配方、超高精密制程、全球客户认证积淀，把持封装基板、毫米波高速板材、车规级超高可靠线路板等高附加值市场。行业竞争早已脱离单纯产能与价格比拼，而是高频信号完整性控制、多阶精密制程良率、车规与算力场景定制方案、长期稳定批量供货、全球多区域品质认证能力的综合实力较量。AI算力基建扩张、新能源车渗透率提升、通信技术迭代节奏差异，持续改变各家企业海内外出货规模与行业排名梯队，工艺落后、仅能生产低端单双面板的低效产能逐步收缩出清。

全球PCB产业整体朝着高频高速高密度、IC载板自主化、柔性轻薄集成、绿色低碳制程、车规算力专用定制方向迭代升级。面向AI服务器、6G通信开发数十层超高阶厚铜高速线路板，保障大带宽低损耗信号传输；封装基板作为芯片封装核心载体，成为各国产业链安全攻坚重点；超薄高弯折柔性线路适配折叠终端、车载显示模组；无卤素环保油墨、节能电镀、废液闭环回收等绿色工艺全面普及落地；针对动力电池、车载电控、算力加速卡打造耐高温、高散热、高抗干扰专用PCB体系；全球同步完善线路板可靠性、电磁兼容

、环保材料统一检测标准，产业链协同攻克高端激光钻孔设备、高频覆铜板、超薄铜箔等核心配套短板。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对全球及国内PCB行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 统计范围及所属行业

第一节 统计范围界定

一、pcb定义

二、pcb产品特征

第二节 pcb行业归属

一、《国民经济行业分类》

二、《统计用产品分类目录》

第三节 全球及国内pcb市场规模

一、2022-2025年全球pcb市场规模

二、2022-2025年国内pcb市场规模

第四节 pcb行业发展现状分析

一、行业生命周期

二、行业进入壁垒

三、行业成长性

四、行业盈利性

五、行业成熟度

第五节 pcb行业发展影响因素

一、行业发展有利因素

二、行业发展不利因素

第二章 国内外市场占有率及排名

第一节 全球pcb行业发展状况概览

一、全球pcb产能及区域分布

二、全球pcb产品结构

第二节 全球pcb市场竞争分析

一、全球pcb市场集中度

二、全球pcb行业竞争梯队

1.第一梯队

2.第二梯队

3.第三梯队

第三节 全球pcb领先企业市场占有率及排名(按营收)

一、2023-2025年全球pcb领先企业营业收入

二、2023-2025年全球pcb领先企业市场份额

三、2023-2025年全球pcb领先企业排名

第四节 国内pcb领先企业市场占有率及排名(按营收)

一、2023-2025年国内pcb领先企业营业收入

二、2023-2025年国内pcb领先企业市场份额

三、2023-2025年国内pcb领先企业排名

第五节 2025年全球pcb行业资本运作分析

一、2025年全球pcb行业重大投资并购事件

二、2025年全球pcb行业重大投资并购事件对行业的影响分析

第三章 全球pcb行业主要国家（地区）分析

第一节 美国pcb行业分析

一、发展历程

二、发展特征

三、2023-2025年美国pcb市场规模

四、2026-2031年美国pcb市场规模预测

五、美国pcb行业典型企业分析

第二节 德国pcb行业分析

一、发展历程

二、发展特征

三、2023-2025年德国pcb市场规模

四、2026-2031年德国pcb市场规模预测

五、德国pcb行业典型企业分析

第三节 日本pcb行业分析

一、发展历程

二、发展特征

三、2023-2025年日本pcb市场规模

四、2026-2031年日本pcb市场规模预测

五、日本pcb行业典型企业分析

第四节 韩国pcb行业分析

一、发展历程

二、发展特征

三、2023-2025年韩国pcb市场规模

四、2026-2031年韩国pcb市场规模预测

五、韩国pcb行业典型企业分析

第五节 中国pcb行业分析

一、发展历程

二、发展特征

三、2023-2025年中国pcb市场规模

四、2026-2031年中国pcb市场规模预测

五、中国pcb行业典型企业分析

第四章 pcb细分行业分析

第一节 刚性多层板

一、全球刚性多层板市场规模(2021vs2025vs2030)

二、全球刚性多层板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

三、中国刚性多层板市场规模(2021vs2025vs2030)

四、中国刚性多层板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

五、刚性多层板未来发展趋势预测

第二节 hdi板

一、全球hdi板市场规模(2021vs2025vs2030)

二、全球hdi板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

三、中国hdi板市场规模(2021vs2025vs2030)

四、中国hdi板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

五、hdi板未来发展趋势预测

第三节 柔性板(fpc)

一、全球柔性板(fpc)市场规模(2021vs2025vs2030)

二、全球柔性板(fpc)主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

三、中国柔性板(fpc)市场规模(2021vs2025vs2030)

四、中国柔性板(fpc)主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

五、柔性板(fpc)未来发展趋势预测

第四节 ic载板

一、全球ic载板市场规模(2021vs2025vs2030)

二、全球ic载板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

三、中国ic载板市场规模(2021vs2025vs2030)

四、中国ic载板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

五、ic载板未来发展趋势预测

第五节 刚挠结合板

一、全球刚挠结合板市场规模(2021vs2025vs2030)

二、全球刚挠结合板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

三、中国刚挠结合板市场规模(2021vs2025vs2030)

四、中国刚挠结合板主要供应商及其市场份额(按2025年营收)

五、刚挠结合板未来发展趋势预测

第五章 pcb产业链分析

第一节 pcb产业链结构解析

一、pcb产业链结构示意图

二、pcb产业链全景图

三、pcb产业发展热力地图

第二节 pcb产业链上游分析

一、pcb成本结构

二、2023-2025年上游行业发展现状

三、2026-2031年上游行业发展趋势

第三节 pcb产业链中游分析

一、pcb中游行业分布

二、2023-2025年中游行业发展现状

三、2026-2031年中游行业发展趋势

第四节 pcb产业链下游分析

一、pcb下游行业分布

二、2023-2025年下游行业发展现状

三、2026-2031年下游行业发展趋势

四、下游需求对pcb行业的影响

第六章 pcb领先企业分析

第一节 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第二节 东山精密制造股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第三节 深南电路股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第四节 沪电股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第五节 胜宏科技(惠州)股份有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业pcb产品分析
- 三、2023-2025年企业pcb业务经营分析
- 四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析
- 五、企业最新发展动态及未来发展规划

第六节 景旺电子科技股份有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业pcb产品分析
- 三、2023-2025年企业pcb业务经营分析
- 四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析
- 五、企业最新发展动态及未来发展规划

第七节 生益电子股份有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业pcb产品分析
- 三、2023-2025年企业pcb业务经营分析
- 四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析
- 五、企业最新发展动态及未来发展规划

第八节 崇达技术股份有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业pcb产品分析
- 三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第九节 广州兴森快捷电路科技股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第十节 深圳嘉立创科技集团股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业pcb产品分析

三、2023-2025年企业pcb业务经营分析

四、企业行业市场地位及对行业的影响力分析

五、企业最新发展动态及未来发展规划

第七章 pcb行业swot分析及发展策略

第一节 pcb行业发展驱动因素

一、市场需求

二、技术变革

三、政策法规

四、产业升级

五、全球化分工

第二节 pcb行业发展swot分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机遇分析

四、挑战分析

第三节 基于swot分析的pcb行业发展策略

一、so策略

二、wo策略

三、st策略

四、wt策略

第八章 pcb行业商业模式及运营模式

第一节 pcb行业商业模式

一、配套直销模式

二、层级分销模式

三、技术授权与服务模式

四、模块化与平台化供货模式

第二节 pcb行业运营模式分析

一、研发运营

二、生产运营

三、供应链运营

四、质量运营

五、全球化运营

第九章 主要研究结论

第一节 pcb行业发展潜力研究结论

第二节 pcb主要供应商排名研究结论

第十章 研究方法与数据来源

第一节 研究方法

一、桌面研究

二、文献研究

三、抽样调研

第二节 数据来源

一、一手信息来源

二、二手信息来源

第三节 数据交互验证

第四节 免责声明

图表目录：

图表：全球pcb产品结构

图表：全球pcb市场集中度

图表：pcb行业发展趋势

图表：pcb行业供应链分析

图表：pcb行业销售模式分析

图表：pcb产业链结构示意图

图表：2023-2025年全球pcb市场规模

图表：2023-2025年中国pcb市场规模

图表：2025年全球pcb产能区域分布图

图表：全球主要pcb供应商市场份额及排名

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4068354

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260615/4068354.shtml>

在线订购：[点击这里](#)